

泉州市科学技术局文件

泉科〔2023〕68号

泉州市科学技术局关于 2023 年集成电路设计补助资金申报工作的补充通知

各县（市、区）科技局，丰泽区、石狮市工业信息化和科技局，泉州开发区、泉州台商投资区科技经济发展局，泉州半导体高新技术产业园区管委会：

为贯彻落实《泉州市人民政府办公室关于印发泉州晋江国际机场净空保护规定和加快泉州市数字经济发展若干措施的通知》（泉政办〔2022〕7号），推动我市集成电路设计产业发展，现将 2023 年度集成电路设计补助资金申报工作有关事项补充通知如下：

一、集成电路设计企业新增财政贡献奖励：集成电路设计企业首次年度销售额超过 2000 万元、5000 万元、8000 万元、1 亿元的企业，以企业上年度为基数，自当年度起，连续 3 年将其新增增值税、企业所得税地方留成部分，分别按照 50%、40%、30%、20%的比例奖励企业，单一企业年度奖励总额不超过 200 万元。

二、芯片应用企业采购补助:支持芯片应用(包括整机/模块/方案公司等集成电路下游企业)与集成电路设计企业联动发展,按采购额的2%对采购方给予资金补助,单个企业年度补助额不超过200万元;单个企业单个型号芯片年度补助额不超过100万元。

申报企业需提供材料:设计服务合同、发票及付款凭证和结算明细表、第三方机构审计报告,软件及设备环境照片,合同双方的非关联声明或相关证明(提供方与购买方应为非关联关系)等相关证明材料。(外文材料需提供翻译件)。

涉及属地政府兑现奖补,请各县(市、区)结合本地实际制定奖补申报兑现细则。

具体申报对象、条件、要求、流程等参照《泉州市科技局关于开展2023年集成电路设计补助资金申报工作的通知》(泉科〔2023〕36号)要求执行。

联系人:市科技局高新科 谢惠阳

联系电话:0595-22579329



泉州市科学技术局办公室

2023 年 4 月 28 日印发
